



[2000円]

特許庁長官 殿

(特許法第85条に於ける)
の規定による特許出願

昭和48年11月7日

① 日本国特許庁

公開特許公報

① 特開昭 49 - 102726

④ 公開日 昭49.(1974) 9 27

② 特願昭 48 - 11724

② 出願日 昭48.(1973) / . 29

審査請求 有 (金3頁)

庁内整理番号

⑤ 日本分類

6660 48

24A03

6683 37

24D01

- 1 発明の名称 電圧による接層層の形成方法
- 2 特許請求の範囲に記載された発明 2
- 3 発明者 出願人と同じ
- 4 特許出願人

住所 川崎市高津区宮崎1丁目12番地5
氏名 藤 野 昭

5 所付書類の目録

- (1) 原簿原本 1 通
- (2) 明細書 1 通
- (3) 図面五枚表裏 1 通
- (4) 図面 1 通



別 紙

方法。

- 1 発明の名称 電圧による接層層の形成方法

2 特許請求の範囲

1. 導電性表面に高分子またはそれに導平並于状の原料を塗成した材料を電解作用によって塗着させた薄膜成状態の粘着剤層に、あるいはさらにその上に通常の接層剤を塗布して成る接合層に、所定の接層材を塗着させたもの、前記接合層を圧着固化させる接層処理の方法。
2. 導電性表面に高分子またはそれに導平並于状の原料を塗成した材料を電解作用によって塗着させた薄膜成状態の粘着剤層に、あるいはさらに通常の接層剤を塗布して成る接合層に、圧電素子、半導体素子および発光素子のごとき所定の接層材を塗着させ、しかも前記接合層を圧着固化させる接層処理の方法。

3 発明の詳細な説明

一般に全金属向あるいは極めて小さな部曲の金属片を他の被接合物質の表面に接合するには、合成樹脂層等で作られた通常の接層剤を被接合物質に何らかの方法にて直接塗布し乾燥させて両者の接合をなさしめる。しかし接層剤そのものと被接合物質との接合性にはよくとも金属等に対する接層効果は通常きわめて悪く、また安定性も劣る。特に少量の接層剤しか使えないような場合には強固な接層性を得ることが困難である。本発明の方法は金属その他の導電性表面において電解作用をとらなして高分子態を塗着させる電着塗着法によって、塗着した樹脂あるいはこれに原料を配合したものが極めて緻密かつ強固に金属表面に対して接合せらるゝことができるので、これを接合介在層(または中間層)として利用したものである。

すなわち接層層を接合とし、他の部の接合

以上に示した実施例からわかるように本発明の方法は、極めて広い利用面がある。そして結合材料のやに導性体、導体、半導体あるいは絶縁体、また電子材料としての有機物でもつて、物質の微粒子と、電場磁場環境中に存在させて電離することにより、その電気的物性を付与した結合層を形成することができる。

例えば上に述べた実施例のはかニモ、電子の電気的運動と金属体の機械的運動とを能率よく変換するためのトランジューサあるいは種々な微小な電気的結合層の組合せなどにより、極めて効率的な手段となり、高度性にも富む方法である。

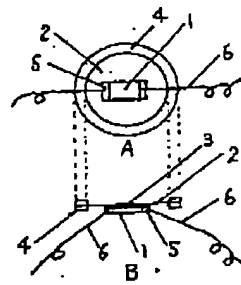
4. 図面の簡単な説明

第1図Aは金属導電層に半導体要素を貼着した上側図であり、第1図Bはその側面図を例示したものである。

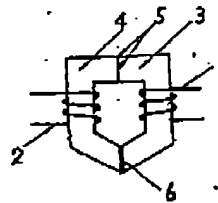
そして第2図は電気回路の概略を示す原理図である。

特許出願人 松下 電 器

特開 昭49-102726 (G)



第1図



第2図

CATIONIC ELECTRODEPOSITION PROCESS AND COATING COMPOSITION FOR CATIONIC ELECTRODEPOSITION

Patent Number: EP0854207
 Publication date: 1998-07-22
 Inventor(s): KAWAKAMI ICHIRO (JP); SAKAMOTO HIROYUKI (JP); HORI HITOSHI (JP); SAITO TAKAO (JP); NISHIO MASAHIRO (JP)
 Applicant(s): NIPPON PAINT CO LTD (JP)
 Requested Patent: ☐ EP0854207, A4, B1
 Application Number: EP19970932983 19970723
 Priority Number (s): WO1997JP02537 19970723; JP19960213019 19960723; JP19960327832 19961122
 IPC Classification: C25D13/00; C09D5/44
 EC Classification: C09D5/44
 Equivalents: AU3633597, ☐ AU709714, CA2232638, CN1118590C, CN1198192, CN1485378, ☐ DE69727656D, ☐ DE69727656T, JP3259274B2, TW426718, ☐ US6106684, ☐ WO9803701
 Cited Documents:

Abstract

A cation electrodeposition coating process and cation electrodeposition coating composition that have a sufficient throwing power are provided. A process for cationic electrodeposition coating which comprises the steps of: (1) immersing a substrate in a cationic electrodeposition coating composition; (2) applying a voltage between an anode and said substrate, which serves as a cathode, to thereby cause coat film deposition; and (3) further applying a voltage to the coat film deposited so as to increase electric resistance per unit volume of said coat film, wherein, in said step (3), coat films are deposited at those sites of the substrate where coat films have not yet been deposited, said cationic electrodeposition coating composition having a time point when the electric resistance per unit volume of the coat film deposited increases in the course of electrodeposition under constant-current conditions.

Data supplied from the esp@cenet database - 12